

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-007

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称</b>	浙商基金、长城财富保险资管、途灵资产、上海雷钧私募、交银人寿、中信建投证券、中欧基金、汇华理财、中金公司、Pinpoint Asset Management、鹏扬基金、中航基金、浙商上海资管、LCRICH CAPITAL MANAGEMENT、南方基金、山西证券、中华财险、中银基金、博时基金、东方阿尔法基金、杭州正鑫私募、长盛基金、广发基金、九泰基金、季胜投资、恒盈资产、人保资产、源乘私募、华泰保兴基金、凯石基金、东证资管、第五公理投资、雪石资产、创金合信基金、光证资管、理臻投资、财通基金、太平洋资管、泰康资产、嘉合基金、上海保银私募、财通证券资管、五地私募、正圆私募、中金基金、东方基金、金鹰基金、国投证券、汇添富基金、长江资管、中加基金、中意资产、中兵投资、国金基金、圆信永丰基金、西部利得基金、中海基金、百嘉基金、富国基金、磐厚动量、路博迈基金、汐泰投资、民生加银基金、国寿安保基金、青岛朋元资管、中邮证券、广发证券、平安基金、中信证券资管、浦银安盛基金、星石投资、中银理财、中银国际证券、兴合基金、东兴基金、利位投资、德睿恒丰资管、汇丰晋信基金、中国人寿养老保险、敦和资管、同犇投资、盘京投资、银华基金、全天候私募证券投资基金、沅杨资产、光大保德信基金、英大国际信托、财通证券、国金证券、招商基金管理有限公司、长城证券、国联证券、西部证券、华泰证券、天风证券、德邦证券资管、嘉实基金、中信建投、杭银理财、中信保诚基金、浙商证券、中泰证券、信达澳亚基金、太平基金、

	南土资产、平安证券、国信证券、易鑫安资管、易方达基金。
时间	2024年10月16日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p><b>一、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士介绍公司 2024 年三季度业绩与经营情况</b></p> <p>公司 2024 年第三季度实现营收 3.10 亿元，同比增长 52.47%，环比增长 26.03%。公司 2024 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 5,116 万元，同比增长 171.09%，环比增长 358.34%，扣非后的净利润为 4,843 万元，同比增长 246.47%。目前公司所处行业正处于上游设计公司库存逐步消化及下游需求逐步回暖的阶段，同时第三季度一般是电子行业的传统旺季，受益于市场对测试的需求明显增加、部分新客户导入和老客户的新产品通过验证并且进入到量产，公司第三季度的营收和利润同比和环比都取得比较大的增幅。</p> <p>公司 2024 年前三季度总营业收入合计为 7.40 亿元，已超过去年全年，同比增长 43.62%。公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 6,202 万元，同比下降 30.81%，扣非后的净利润为 5,265 万元，同比下降 20.98%。公司 2024 年上半年股份支付费用为 3,382.52 万元，第三季度为 1,037.72 万元，前三季度共产生股份支付费用 4,420.24 万元，如果剔除股份支付的影响，前三季度净利润为 1.06 亿元。</p> <p>今年公司继续在高算力高性能芯片、车规级及工业级高可靠性芯片等方向进行重点研发，公司第三季度研发投入为 3,690 万元，占营收的比重为 11.88%。随着一些研发项目的量产及营收提升之后，第三季度研发费用占营收的比重同比略有下降；前三季度研发投入合计 1.01 亿元，较上年同期增加 43.73%，主要是因为研发人员和薪酬以及研发费用中的股份支付费用较上年同期增幅较大。</p>

公司在南京的募投项目伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目已于7月下旬完成了厂房竣工验收，8月份已开始试生产，后续陆续还有设备进厂；无锡的项目目前还在施工中，预计明年底会完成土建工作；天津子公司目前已有部分机台进厂进行部分研发工作；上海两个厂目前满产；深圳厂也已经实现量产。

## **二、投资者提问**

### **1、按产品拆分下第三季度的毛利率？**

答：不同产品毛利率水平按高低排序是高端产品的CP测试、高端产品的FT测试、中端产品的CP测试和中端产品的FT测试。公司第一季度主营业务毛利率是25.36%，第二季度是30.06%，第三季度由于高端产品占比有明显提升使得主营业务毛利率上升至41.75%。

### **2、后续毛利率的展望？**

答：第四季度行业的景气程度预计好于第三季度。目前市场对高端产品的测试需求是比较旺盛的，公司高端产品的产能也在不断增加，第四季度的营收和毛利环比第三季度预计还有提升的空间。

### **3、中高端产品在第四季度的预计占比？**

答：公司上半年高端产品测试占比为67%，中端产品测试占比为33%。第三季度高端产品测试占比大幅提升至73%，中端产品测试占比为27%，第四季度高端产品的占比预计会略有增加。

### **4、按芯片类型拆分下主营业务收入？**

答：消费级芯片占60%，工规级芯片占28%，车规级芯片占12%。其中CPU、GPU、AI等高算力芯片是包含在工规级芯片类别，占15%左右。

### **5、今明两年的折旧？**

答：预估今年设备折旧大概3.1亿左右，另外还有厂房的折旧，但厂房折旧的期限比较长，所以对利润的影响不太大。

#### **6、算力的布局和后续增长怎么看？**

答：CPU、GPU、AI等高算力高性能芯片、车规级及工业级等高可靠性芯片测试一直是公司重点布局的方向，目前这方面产品已经部分在公司验证并进入量产，还有些在验证过程中。随着客户产品未来逐步放量后，这方面的产品会有增长。

#### **7、后续研发费用的增长水平？**

答：前三季度研发投入合计1.01亿元，较上年同期增加43.73%，主要是因为研发人员和薪酬以及研发费用中的股份支付费用较上年同期增幅较大。从长期看，研发费用绝对值会有所增加，但研发费用占营收的比重会随着一些研发项目产业化和营收增长而有所下降。

#### **8、展望下明年的测试行业？**

答：世界半导体贸易统计组织（WSTS）在其最新预测中表示，预计2024年全球半导体市场将实现16%的增长。根据工业和信息化部运行监测协调局数据，2024年1月份至8月份，我国集成电路产量为2,845亿块，同比增长26.6%，而国内第三方测试行业目前整体规模较小。随着国内半导体行业的增长以及产业链转移的影响，第三方测试行业将获得超过行业增速的增量市场。

#### **9、可转债的进度？**

答：目前是在第一轮反馈问题的过程中，但可转债的项目开展并不受再融资进展的影响，目前有部分银行贷款支持。

#### **10、现在在手订单能看多久？**

答：公司是在与客户确定初步合作关系后，通过签订测试服务协议约定双方的权利义务，客户通常通过下订单的方式来提出测试需求。协议是一个长期的合作关系，但下订单的周期是短期的行为，可能一个月或者一个季度。

	<p><b>11、10月份的产能利用率？</b></p> <p>答：目前高端机台基本上是满产，产能利用率达到90%以上，接近满产，中端机台大概80%以上。</p> <p><b>12、公司相比其他第三方测试的优势？</b></p> <p>答：首先是测试设备规模及产能规模优势，集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，足够的测试产能能让公司快速响应客户的测试需求。公司拥有较多高端测试设备的优势能满足行业内高端测试客户的需要；其次是客户优势，从公开披露的资料可以看到公司的客户基本上都是国内排名最靠前的一些设计公司，公司的测试水准是得到了国内知名设计公司的认可；最后是公司的技术优势，在测试作业的自动化方面，公司自主开发了MES生产管理系统，在测试方案开发方面和在测试技术水平方面的优势都比较明显。</p>
<p><b>风险提示</b></p>	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>